



2008年11月20日

# 日本電子材料株式会社

## 2008年度 中間決算説明会

### 将来の見通しに関する記述についての注意

本資料で記述されている業績予想および将来予測は、現時点で入手可能な情報に基づき当社が判断した予想であり、潜在的なリスクや不確実性が含まれています。そのため、様々な要因の変化により、実際の業績は記述されている将来の見通しとは異なる結果となる可能性があることをご承知おきください。

# 中間期の概要

## 下期の課題と取り組み

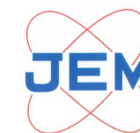
## 事業環境

メモリー 製品価格下落  
ロジック 半導体業界不振に伴う需要縮小

## 結果

売上 前年同期比 8%増  
利益 大幅減少  
Mタイプ MCのサンプル出荷

# 2008年度中間期 連結業績

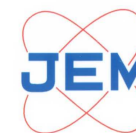


単位: 億円

	2007年度 中間実績	2008年度 中間実績
売上高	64.6	69.7
営業利益	4.9	1.1
率(%)	7.6	1.6
経常利益	5.3	1.2
率(%)	8.3	1.8
当期純利益	2.1	0.9
率(%)	3.4	1.3

*Your Probing Partner*

# メモリー 中間期 (単体)



VC、VSの拡販による  
需要取込で増加

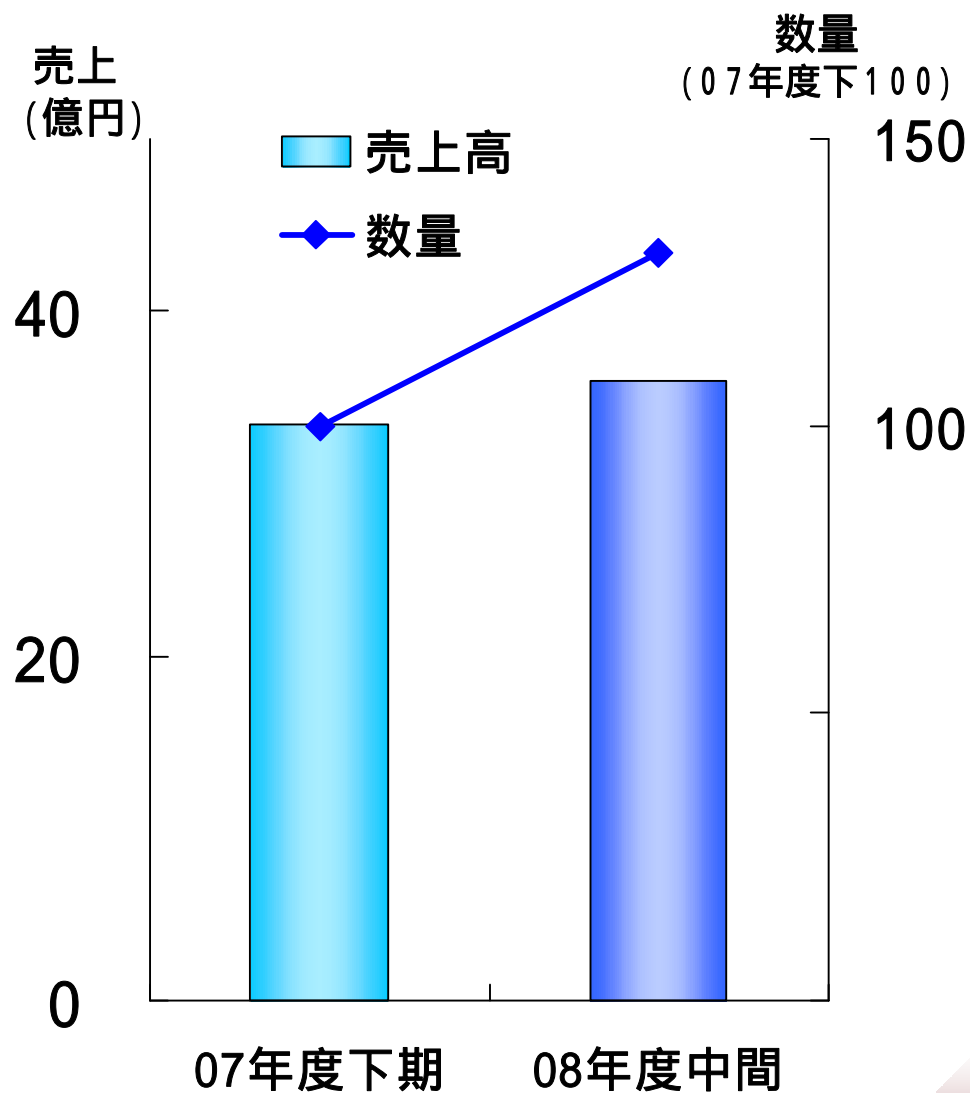
売上

前下期比 8%増

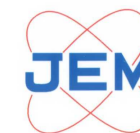
韓国、国内向け  
共に堅調

数量

前下期比 30%増



# ロジック 中間期 (単体)



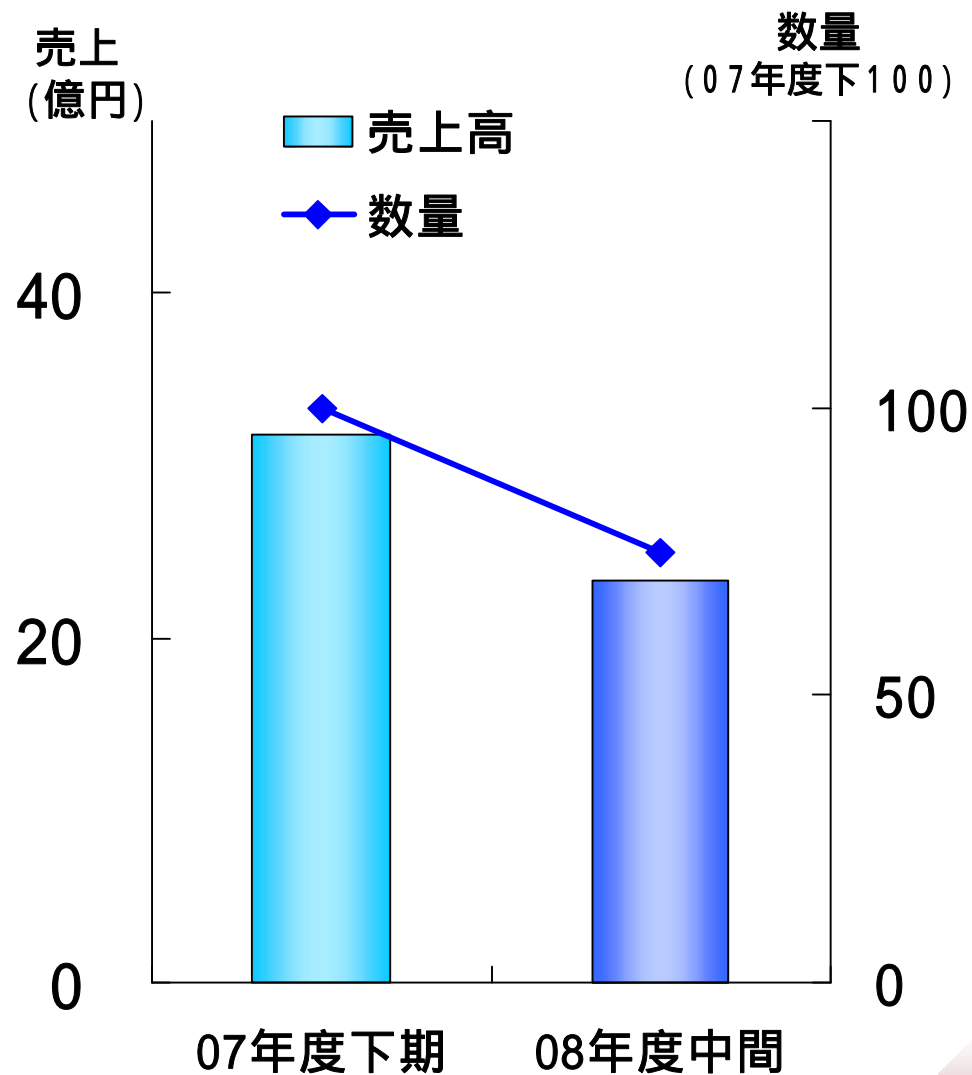
## 受注数量の大幅ダウン

売上

前下期比 27%減

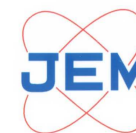
数量

前下期比 25%減



*Your Probing Partner*

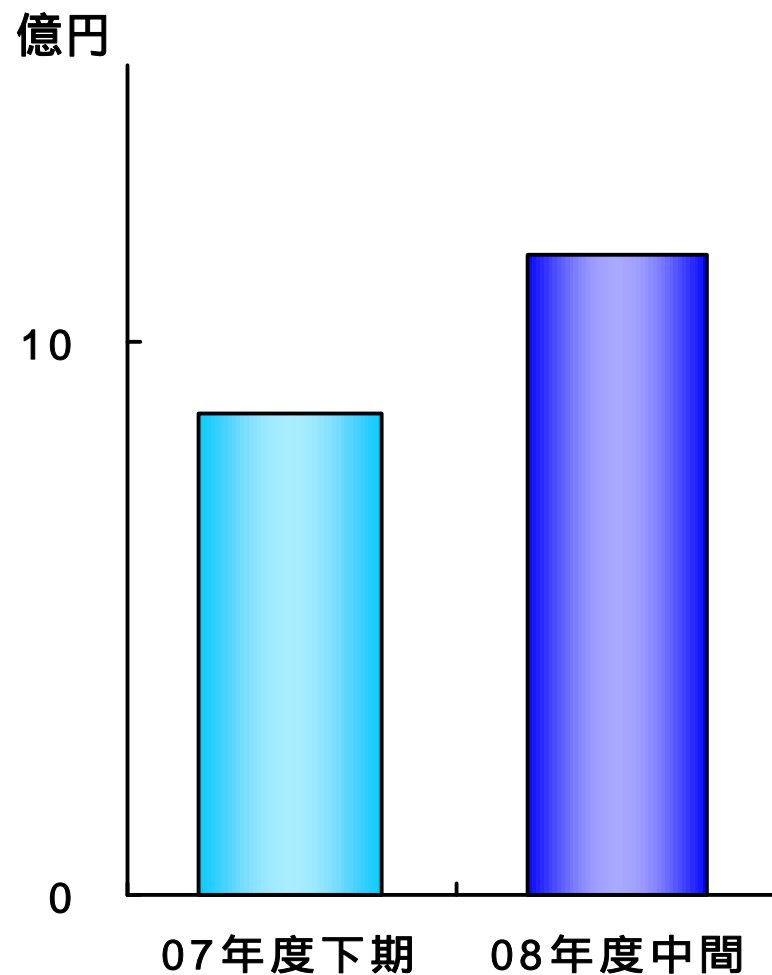
# 海外 中間期



アメリカ Vタイプの拡販  
による増加

アメリカ売上

前下期比 33%増  
(Vタイプ84%増)



*Your Probing Partner*

中間期の概要

下期の課題と取り組み

## 事業環境

価格下落

メモリー業界不振に伴う需要減？

## 課題、施策

売上確保、利益向上

V Sの更なる原価低減

超多ピンV Cの拡販

海外向けV C、V Sの拡販

*Your Probing Partner*

## 事業環境

景気後退により市場の更なる低迷

## 課題、施策

未開拓市場の掘り起こし

新合金針の投入

CN、VEシリーズの拡販

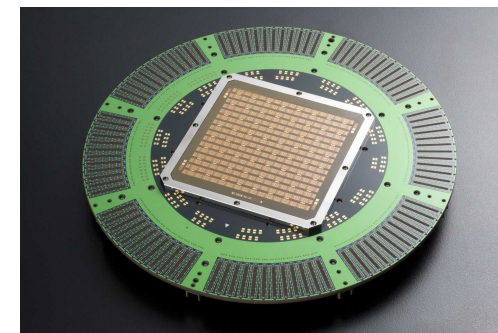
VTシリーズの投入

MCシリーズの開発状況

顧客評価用サンプル出荷完了

高性能プローブの開発完了

300mm一括の開発加速



## 高性能プローブの特性

大オーバードライブ対応  
高耐久性を持つ針材  
低針圧・高安定接触

ピン単位の針交換技術の確立

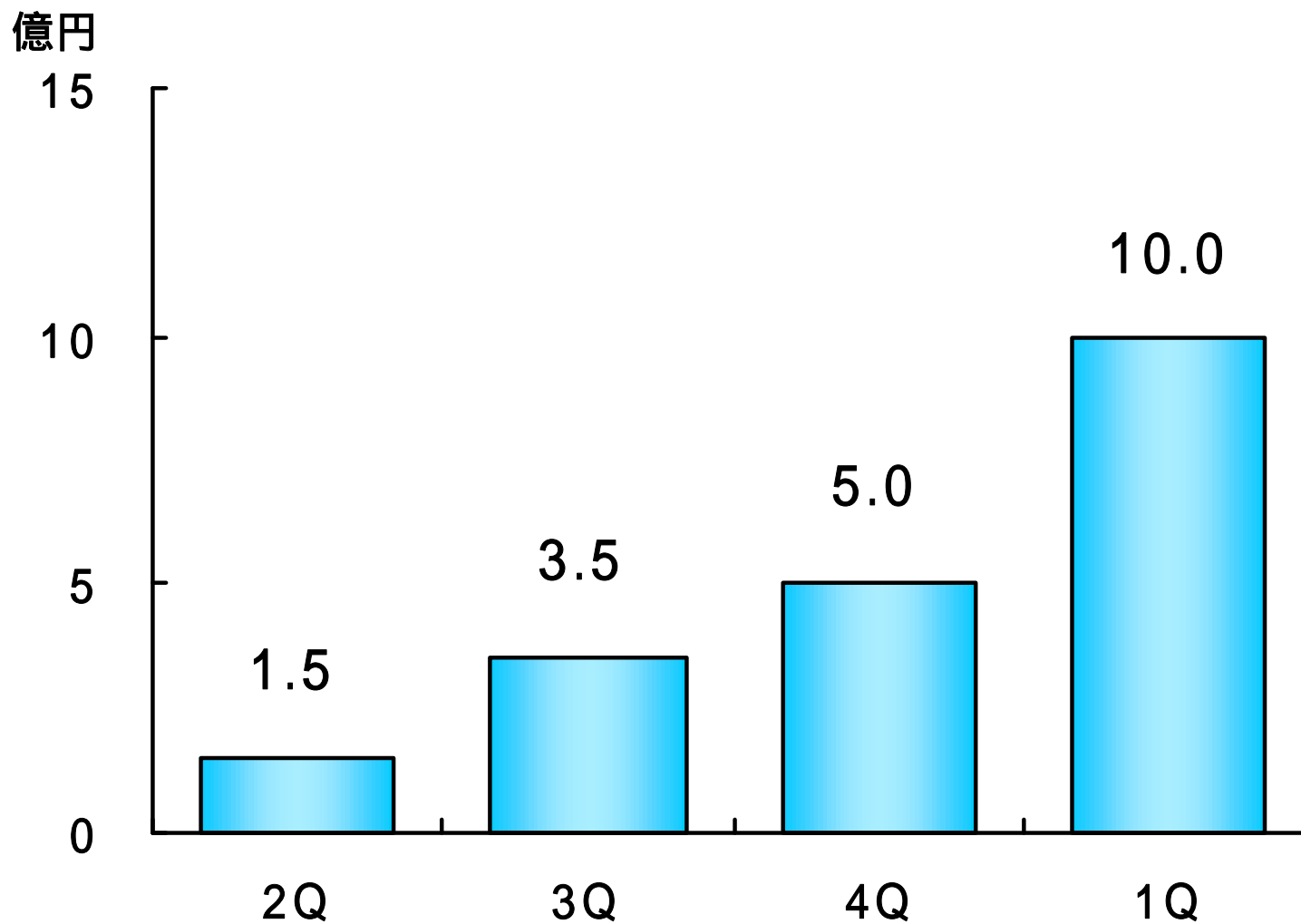
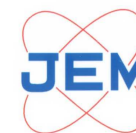
## 事業環境

メモリーの強い引き合いへの対応力強化  
ロジック客先評価の推進

## 課題、施策

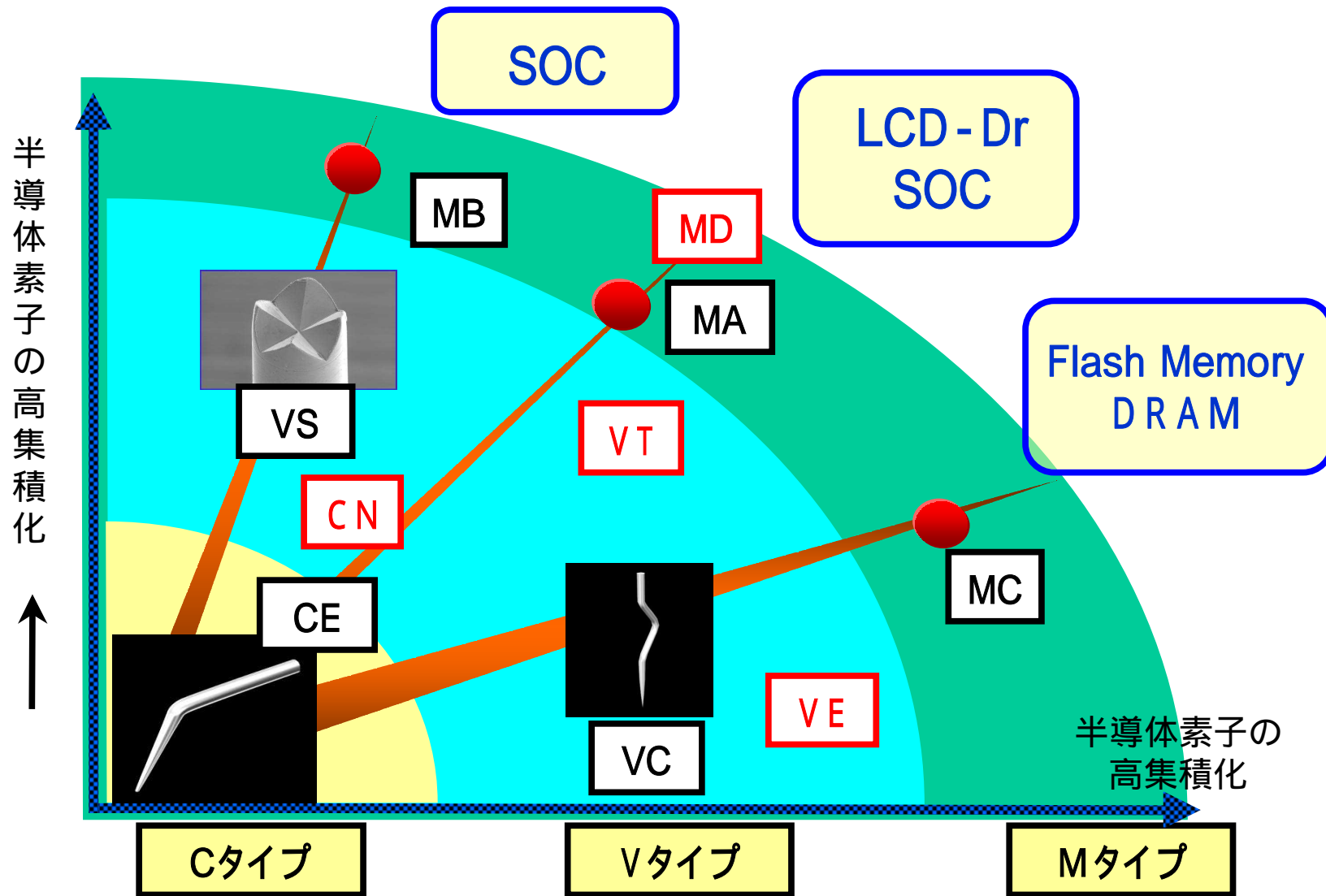
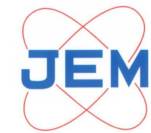
- ・ 200mmの受注獲得(MC)
- ・ 300mmのサンプル出荷(MC)
- ・ 300mmの受注推進(MC)
- ・ SOC向けサンプル出荷(MD)
- ・ 300mm量産ラインの立ち上げ

# Mタイプ 09年度売上計画



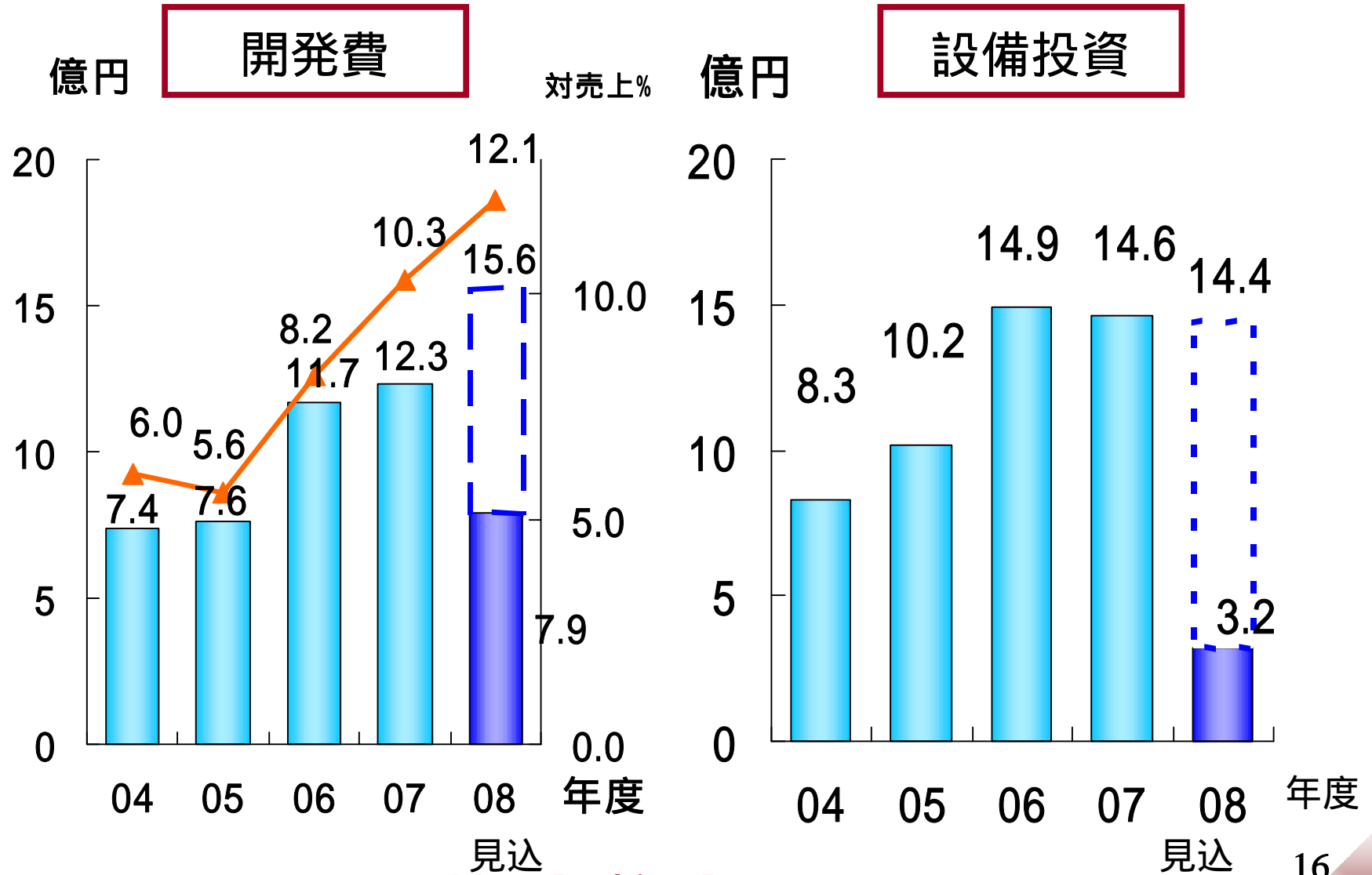
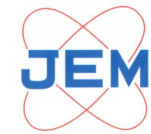
*Your Probing Partner*

# 製品ラインナップ



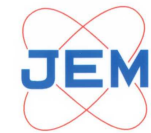
*Your Probing Partner*

# 開発費、設備投資



*Your Probing Partner*

# 通期連結業績見通し



単位: 億円

	2007年度 実績	2008年度 11/12予想
売上高	142.7	128.0
営業利益 率(%)	11.4 8.0	2.4
経常利益 率(%)	12.1 8.5	2.0
当期純利益 率(%)	3.4 2.4	1.4

配当は安定配当として年間20円(中間10、期末10)を予定

*Your Probing Partner*

## ～ 入るを図る ～

売上の極大化へ向け、既存製品の  
価格競争力と性能強化

### メモリー

既存大口顧客向け売上の死守  
更なる追加原価低減の推進

### ロジック

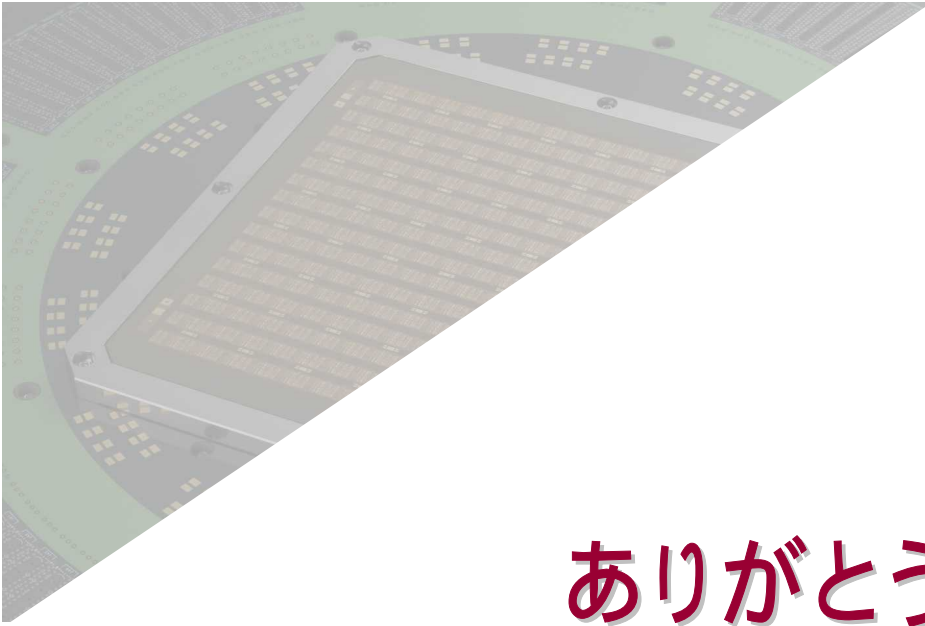
拡販プロジェクトの徹底(重点顧客)

*Your Probing Partner*

## ～ 出るを制す ～

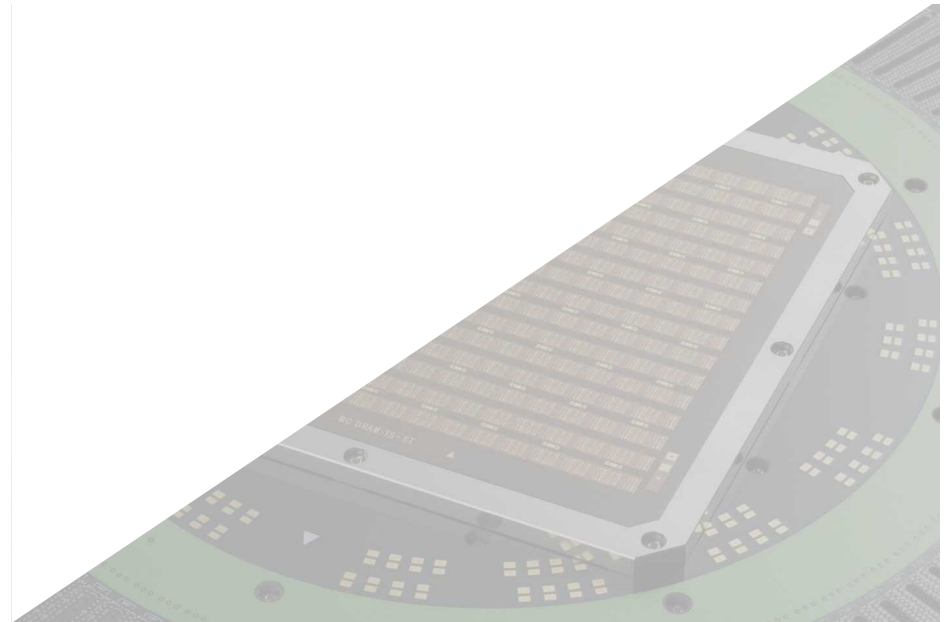
### 収益確保

- ・ 徹底的な原価低減
- ・ 経費、販管費節減
- ・ 固定費削減



ありがとうございました

<http://www.jem-net.co.jp/>

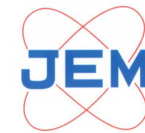


補足資料 決算資料

補足資料 会社概要

# 連結貸借対照表

補足資料



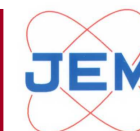
単位：百万円

	2007年度中間		2008年度中間	
	金額	構成比(%)	金額	構成比(%)
<b>資産の部</b>				
流動資産	10,912	67.3	11,103	69.11
有形固定資産	3,590	22.1	3,487	21.7
無形固定資産	357	2.2	348	2.2
投資その他	1,353	8.3	1,128	7.0
<b>資産合計</b>	<b>16,214</b>	<b>100.0</b>	<b>16,067</b>	<b>100.0</b>
<b>負債の部</b>				
流動負債	3,199	19.7	3,380	21.0
固定負債	586	3.6	589	3.7
<b>負債合計</b>	<b>3,785</b>	<b>23.3</b>	<b>3,969</b>	<b>24.7</b>
<b>純資産の部</b>				
株主資本	12,274	75.7	12,284	76.5
評価換算差額等	154	1.0	-186	-1.2
純資産合計	12,428	76.7	12,097	75.3
<b>負債純資産合計</b>	<b>16,214</b>	<b>100.0</b>	<b>16,067</b>	<b>100.0</b>

*Your Probing Partner*

# 連結損益計算書

補足資料



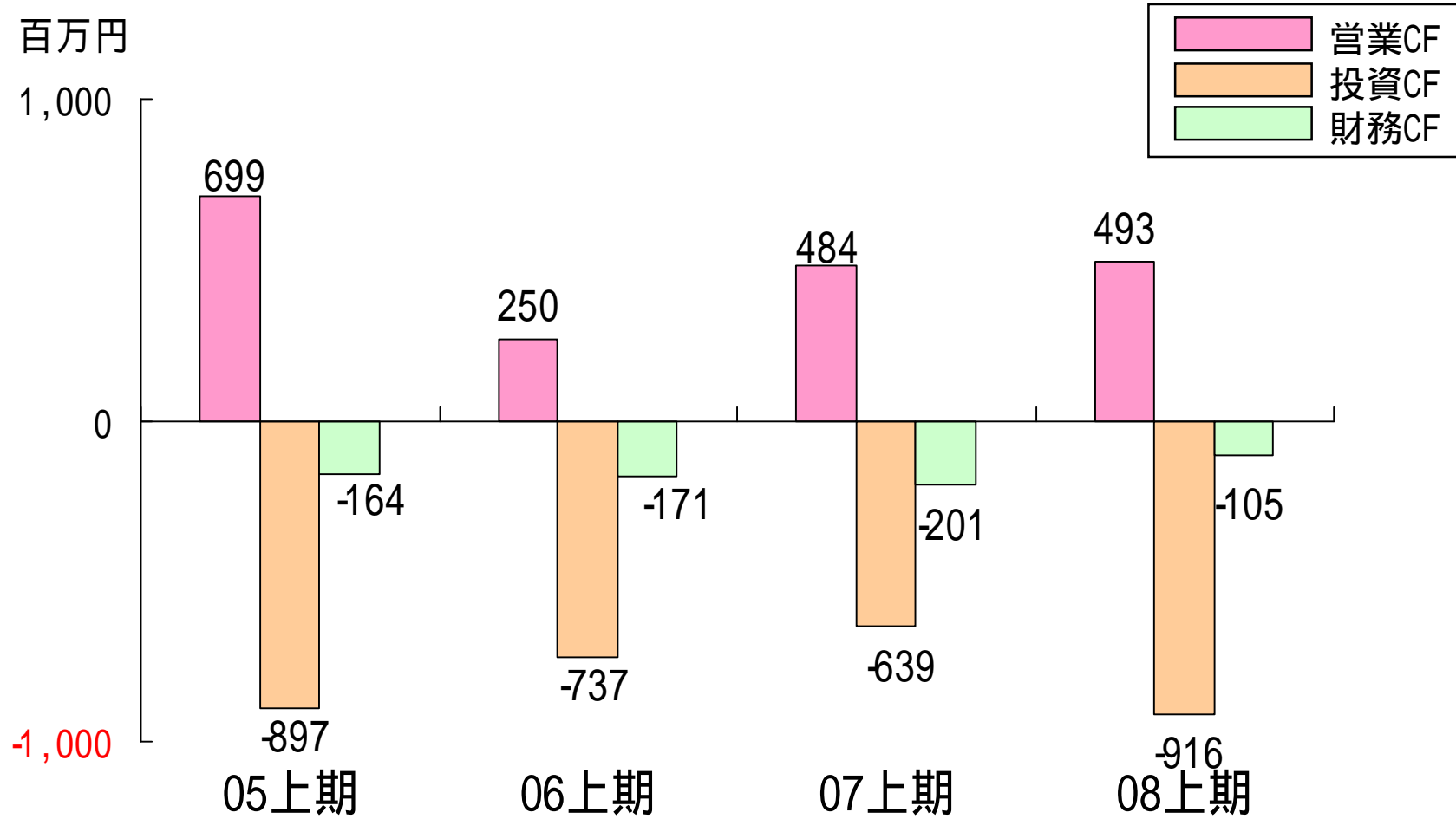
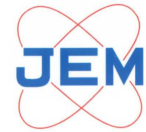
単位：百万円

	2007年度中間		2008年度中間	
	金額	百分比(%)	金額	百分比(%)
売上高	6,463	100.0	6,979	100.0
売上総利益	2,209	34.2	2,054	29.4
販管費	1,715	26.6	1,942	27.8
営業利益	493	7.6	111	1.6
営業外収益	50	0.8	44	0.6
営業外費用	8	0.1	28	0.4
経常利益	535	8.3	128	1.8
特別利益	57	0.9	-	-
特別損失	33	0.5	6	0.1
税金等調整前四半期純利益	559	8.7	122	1.8
法人税等	339	5.3	25	0.4
当期純利益	219	3.4	97	1.3

*Your Probing Partner*

# キャッシュ・フロー

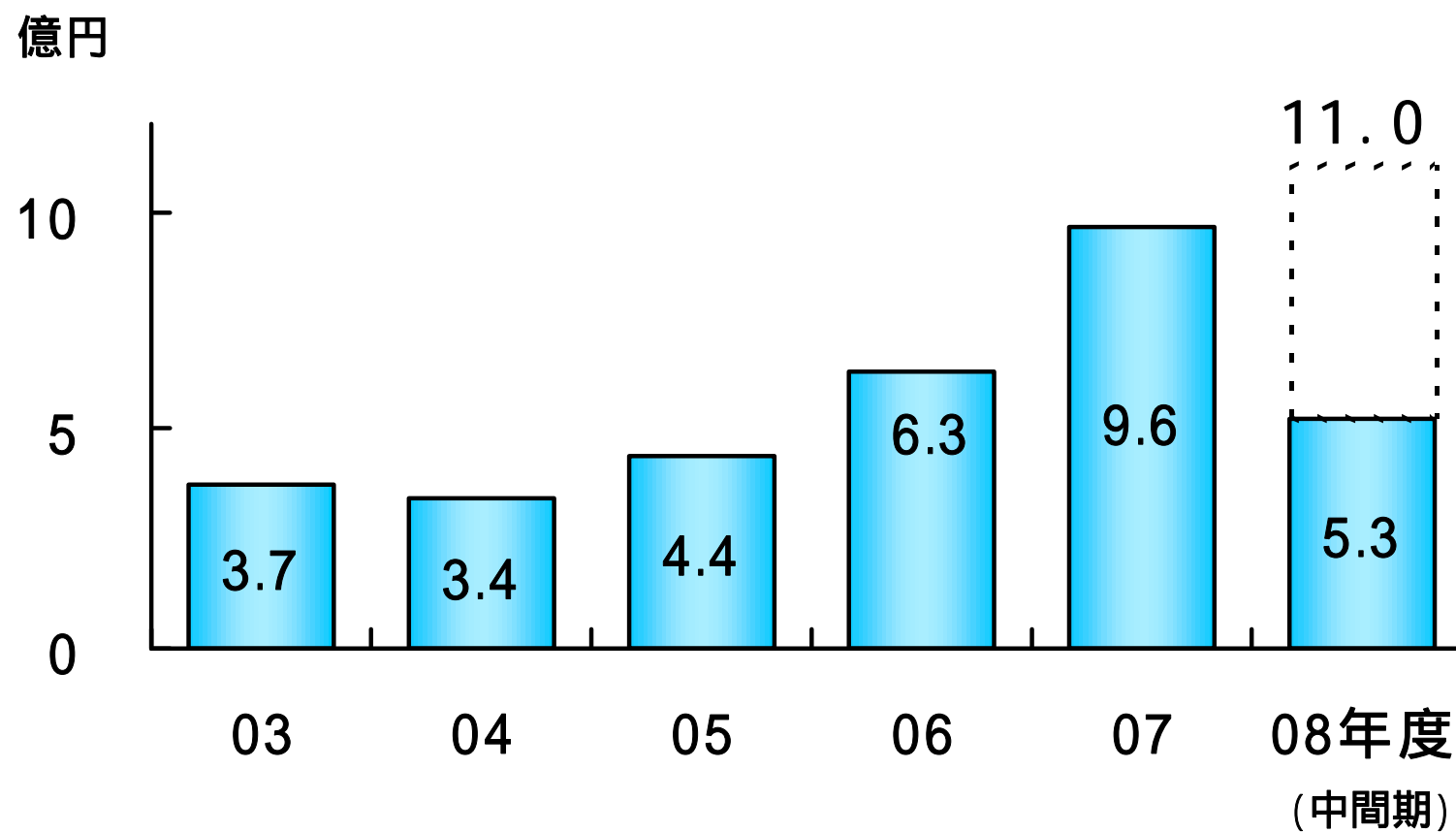
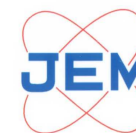
補足資料



*Your Probing Partner*

# 減価償却

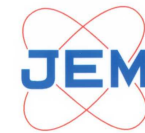
補足資料



*Your Probing Partner*

# 個別、主要子会社

補足資料

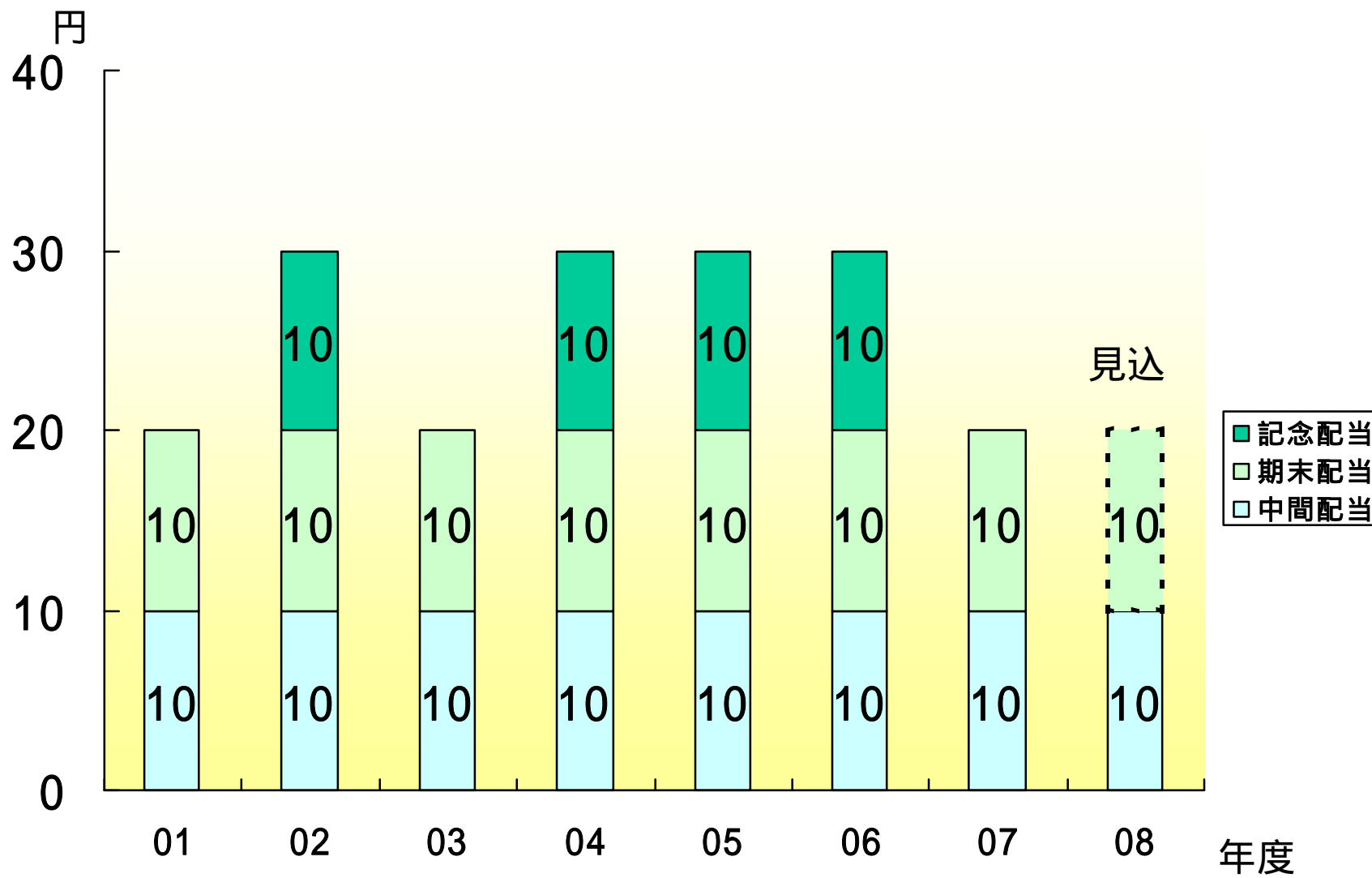
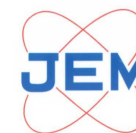


単位：百万円

	2007年度中間				2008年度中間			
	売上高	営業利益	経常利益	当期純利	売上高	営業利益	経常利益	当期純利
個別	5,420	406	634	476	6,159	98	40	95
JEM静岡	680	115	116	50	656	79	80	48
JEMアメリカ	1,012	249	265	160	1,159	157	173	107
JEMヨーロッパ	110	7	7	7	167	30	34	23
JEM台湾	317	10	16	18	176	104	113	109
JEM香港	576	19	15	14	670	37	39	32

# 配当状況、予想

補足資料



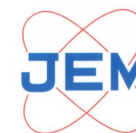
*Your Probing Partner*

補足資料 決算資料

補足資料 会社概要

# 会社概要

補足資料



会社名 日本電子材料株式会社  
**J**APAN **E**LECTRONIC **M**ATERIALS  
CORPORATION

設立 1960年4月

資本金 9億8千万円

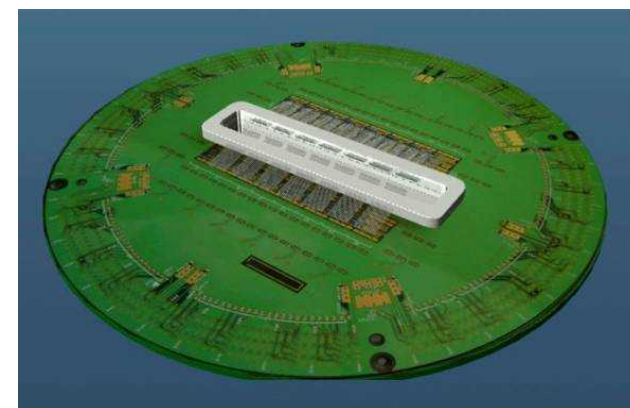
上場 東証1部 (証券コード6855)

子会社等 国内2 海外7

従業員 約1,300名

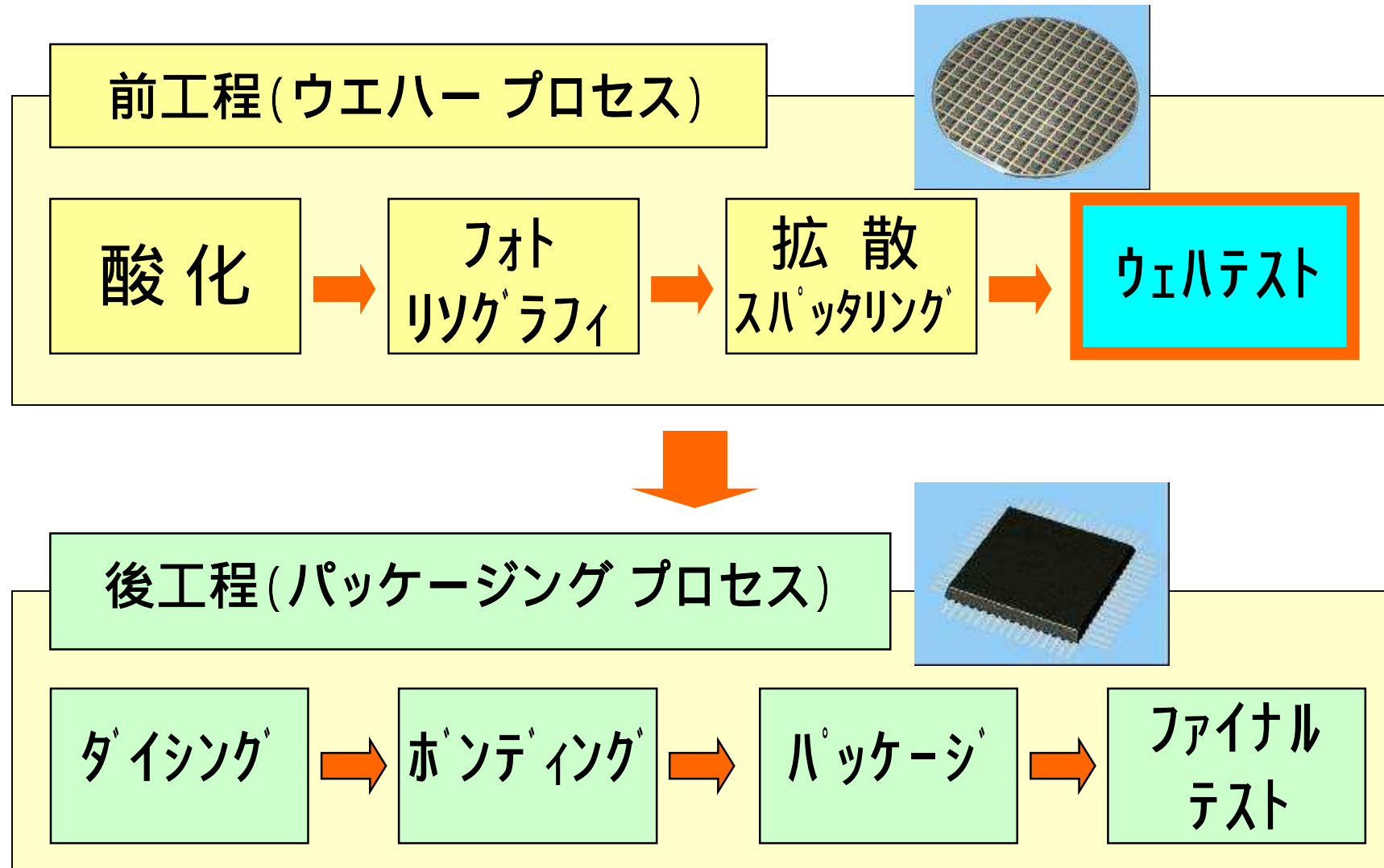
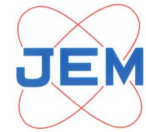
事業内容 半導体検査用部品(プローブカード)

*Your Probing Partner*



# 半導体の製造工程

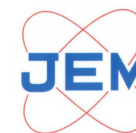
補足資料



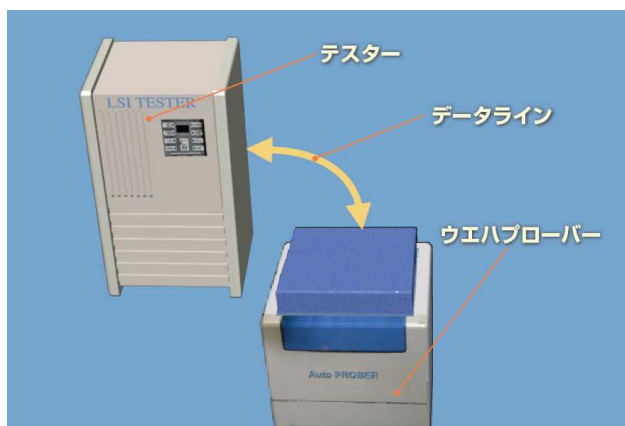
*Your Probing Partner*

# プローブカードとは

補足資料

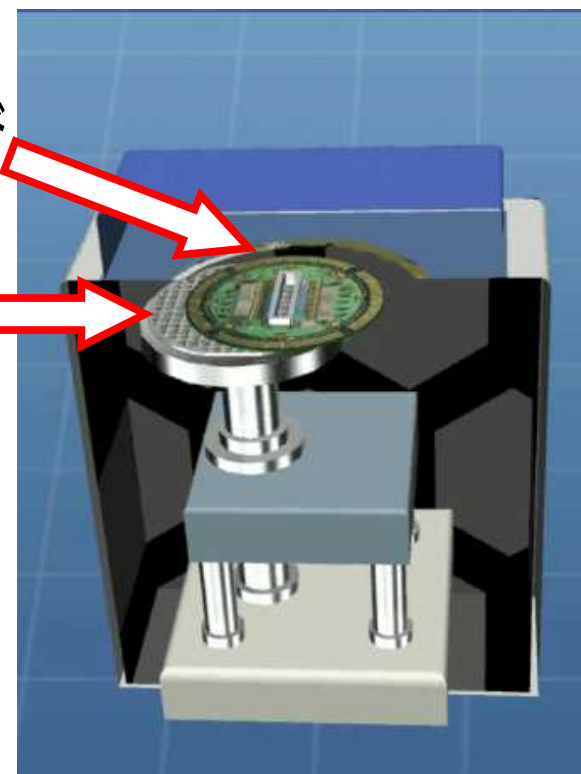


半導体のウエハテスト工程で、テスターからの電気信号をICチップに伝える役割を果たし、半導体製造には必要不可欠な製品です



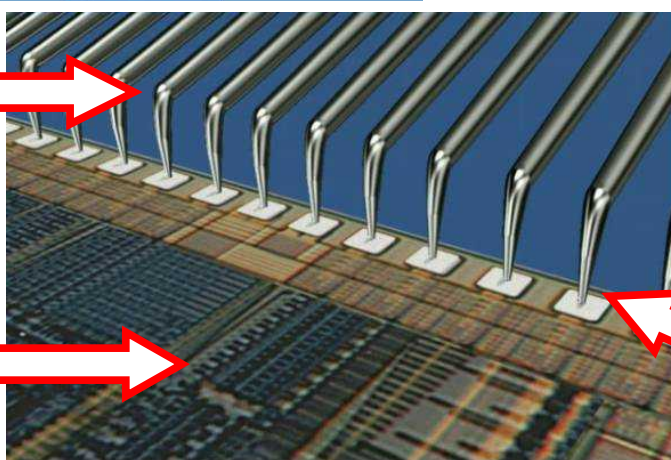
プローブカード

ウエハ



プローブ(針)

ウエハ  
(ICチップ)

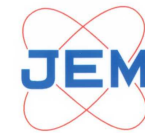


ボンディングパッド(電極)<sub>31</sub>

*Your Probing Partner*

# 国内拠点

補足資料



本社・本社工場(含電子)

本社営業・海外営業

熊本工場

熊本営業



東北営業

東京営業

ジェム静岡

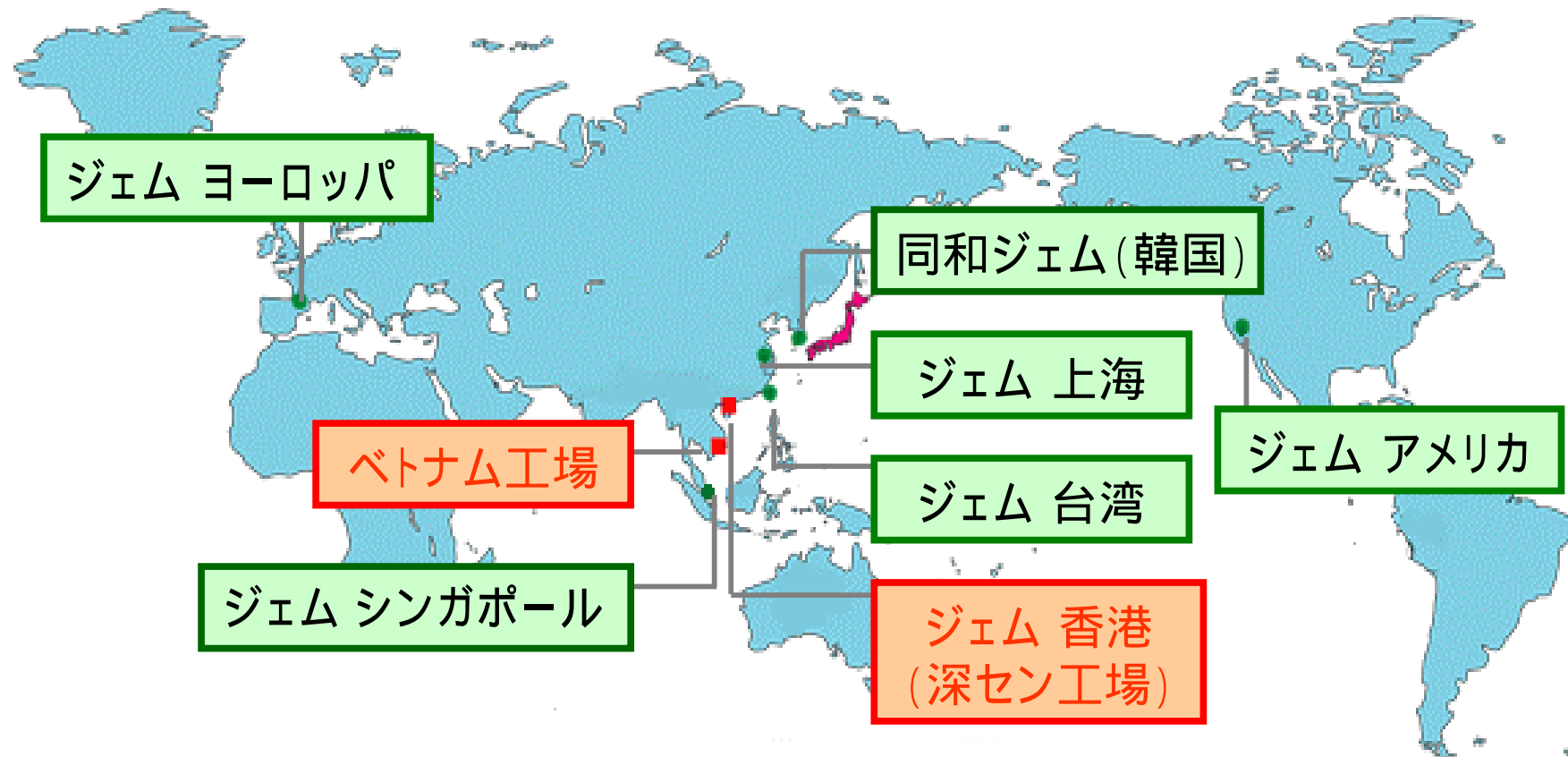
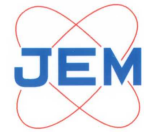
ジェムファインテック



*Your Probing Partner*

# 海外拠点

補足資料

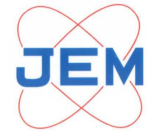


製造および販売拠点  
UNIT生産拠点

*Your Probing Partner*

# プローブカード売上高(上位5社)

補足資料



2007年 単位: \$ M

Cantilever		
1	JEM	65.0
2	MJC	51.1
3	TCL	32.4
4	SV	31.1
5	MPI	30.9

Advanced		
1	FFI	462.2
2	MJC	106.4
3	JEM	61.1
4	Phicom	40.2
5	TSE	33.3

( Sources ; VLSI Research Report )

*Your Probing Partner*

# JEM

## Your Probing Partner

